

Pelnox®

产品名称	ZC-203TI
产品分类	单个半导体 单组份树脂
主要用途	半导体模组
主要功能	单组份 低温固化

固化前性状

(代表值)

项目	条件	单位	ZC-203TI
外观	目测	—	黑色液体
比重	25℃	—	1.76
粘度	25℃	mPa·s	38,000
胶凝时间	150℃ 热板	分	3

标准固化条件 150℃-1.5小时

固化后特性

项目	条件	单位	代表值
硬度	JIS K-7215 25℃	邵氏D	94
热变形温度	JIS K-7191-3	℃	114
玻璃化温度	TMA法	℃	113
线膨胀系数	Tg以下	10 ⁻⁵ /℃	2.3
	Tg以上	10 ⁻⁵ /℃	8.5
弯曲强度	JIS K-6911	MPa	107
弯曲模量	JIS K-6911	MPa	10,500
体积电阻率	JIS K 6911 25℃	Ω-cm	1.4 x 10 ¹⁷
	JIS K 6911 煮沸24小时	Ω-cm	7.9 x 10 ¹⁵
	JIS K 6911 PCT24小时	Ω-cm	1.1 x 10 ¹⁴
吸水率	JIS K 6911 煮沸24小时	wt%	0.38
	JIS K 6911 PCT24小时	wt%	0.66
难燃性	UL-94		V-0

以上数值为参考值并非产品规格

联系方式



PELNOX, LTD.

东京支店

〒103-0023 东京都中央区 日本桥本町3-7-2 MFPR日本桥本町大楼10层
TEL: +81-3-5645-3781 FAX: +81-3-5645-3784

本社研发中心

〒259-1302 神奈川県秦野市菩提8番地7
TEL: +81-463-86-8001 FAX: +81-463-86-8022